



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110428000
2011 年 4 月 29 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

美浦工場製品 代替工場追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

既にお知らせさせていただきましたように、日本での大震災は、TI の美浦工場（東京の北西 40 マイル(64Km)、茨城県）へ大きな被害を招きました。美浦工場チームは一日も早い製造業務の正常化に向け他工場からのチーム支援の下懸命に作業しております。電気および地域のインフラの安定を待って、美浦工場は 5 月に幾つかの生産ラインを再開させ、9 月の全面出荷開始となるフル稼働へ 7 月中旬に復帰することで段階的に生産を回復する予定です。現在、お客様の需要に対する供給継続確保を確実なものにする為に、美浦工場での製品生産導入の評価進行中の大部分について他の代替工場を選定あるいは追加させていただきます。個別製品に関する詳細は、更なる情報が明らかになり次第この通知の更新にて連絡させていただく予定で、鋭意 作業を継続しております。

今回のお知らせは、代替追加製造工場への製品移管についての連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為に、この通知内で明記いたしました基本的な工程技术（ウェハプロセス）について既に認定されている工場への生産移管に向け早急を実施する予定です。基本的な工程技术としてカバーされていない部品（素子）を含む掲載製品の少数の製品種に関しましては、代替の生産工場からの製品出荷を確実なものにする為に、並行して部品（素子）レベルの認定試験を行う予定です。TI は現行 最善の情報/知識に基づき生産移管に必要な全てを本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、再度変更が明確になった場合、本通知の更新にて連絡させていただきます。更に、別表（最終ページ Appendix-A）で明記させていただいております生産能力改善移管についての変更通知は、その内容がより効率的に代替工場の利用を確実なものにできる場合、その変更導入時期を促進いたします。

各生産拠点での認定状況を基に生産拠点選定および部品（素子）レベルの認定試験による前述の移管施策に加え、TI はお客様への製品納入に先立ち、追加の部品（素子）レベルのパラメータの同一性評価および選別工程での歩留まり/選別分類比較評価を行う事でお客様での懸念事項の払拭に向け進めてまいります。TI は供給の遅れを最小限にとどめると共に、品質を伴った製品の供給に努めてまいります。

次ページに詳細を掲載いたしました。TI は本通知発行日より 21 日以内に、本通知受領のご確認をお願いいたします。供給遅延を最小限にとどめるために、TI は部材供給可能な代替工場での生産を 4 月の出荷が開始されるべくすでに施策の実施を開始しいたしております。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	美浦工場製品 代替工場追加 現行 : TI-MIHO(日本) 変更後 : TI-MIHO(日本), TI-RFAB(Dallas, 米国), TI-FFAB(Freising, ドイツ), UMC(台湾), SMIC-TJ(中国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 TI-MIHO工場(日本)製造製品について、TI-MIHO工場の一時的な製造停止により対象製品について代替製造サイトの追加の連絡になります。下表に代替追加サイトを掲載し、対応した製品リストにつきましては対象製品の項をご参照下さい。代替製造サイトへの製品追加移管につきましては直ちに実施開始の予定です。製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

前処理サイト

現行

TI-MIHO(日本)

変更後

TI-MIHO(日本)

TI-RFAB(Dallas, 米国)

TI-FFAB(Freising, ドイツ)

UMC(台湾)

SMIC-TJ(中国)

理由：供給能力確保の為

Miho Process MIHO 工場 工程技術	Additional Site 代替追加サイト	Device Table 対象製品リスト表
A07S	SMIC-TJ	Table 1
A12	FFAB	Table 2
Bicom	FFAB	Table 3
LBC7	UMC, RFAB, FFAB	Table 4

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)および生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)およびラベル上の表示位置は、下記のようになります。

Manufacturing Site	Chip Site 前処理サイト	Chip site code (20L) 前処理サイト記号	Chip country code (21L) 生産国記号
現行	MIHO6	MH6	JPN
	MIHO8	MH8	JPN
追加認定	RFAB	RFB	USA
	FFAB	TID	DEU
	UMC-F8AB	UAB	TWN
	SMIC-TJ	SMT	CHN



図1 出荷ラベルの例

対象製品リスト

対象製品名 Table 1 (A07 Devices - SMIC-TJ)

BQ24104RHLR	TL16C2550IPFB	TL16C2550PFBR	TL16C550DRHB	TL16C752CIRHBRG4
BQ24104RHILT	TL16C2550IPFBG4	TL16C2550PFBRG4	TL16C550DRHBG4	TL16C752CRHB
BQ24109RHLR	TL16C2550IPFBR	TL16C550DIRHB	TL16C550DRHBR	TL16C752CRHBR
BQ24109RHRLRG4	TL16C2550IPFBG4	TL16C550DIRHBG4	TL16C550DRHBRG4	TL16C752CRHBRG4
BQ24109RHILT	TL16C2550PFB	TL16C550DIRHBR	TL16C752CIRHB	
BQ24109RHILTG4	TL16C2550PFBG4	TL16C550DIRHBRG4	TL16C752CIRHBR	

対象製品名 Table 2 (A12 Devices - FFAB)

BQ24020DRCR	BQ24026DRCRG4	BQ25015RHILT	SN200602108DCKRG4	TPS3806133DBVR
BQ24020DRCRG4	BQ24031RHLR	BQ25015RHILTG4	TPS3803-01DCKR	TPS3806133DBVRG4
BQ24022DRCR	BQ24031RHRLRG4	HPA00029DBVR	TPS3803-01DCKRG4	TPS3806133DBVT
BQ24022DRCRG4	BQ24031RHILT	HPA00091DRCR	TPS3803G15DCKR	TPS3806133DBVTG4
BQ24023DRCR	BQ24031RHILTG4	HPA00103DBVR	TPS3803G15DCKRG4	TPS61041DBVR
BQ24023DRCRG4	BQ24081DRCR	HPA00104DBVR	TPS3803G15MDCKREP	TPS61041DBVRG4
BQ24024DRCR	BQ24081DRCRG4	HPA00238DRCR	TPS3803G15QDCKREP	V62/04648-02XE
BQ24024DRCRG4	BQ24081DRCT	HPA00239DRCR	TPS3805H33DCKR	V62/04648-03XE
BQ24025DRCR	BQ24081DRCTG4	SN105125DBVR	TPS3805H33DCKRG4	V62/04648-05XE
BQ24025DRCRG4	BQ25015RHLR	SN105125DBVRG4	TPS3805H33MDCKREP	V62/04648-06XE
BQ24026DRCR	BQ25015RHRLRG4	SN200602108DCKR	TPS3805H33QDCKREP	

対象製品名 Table 3 (Bicom Devices - FFAB)

PSR3710A8ZYZR				
---------------	--	--	--	--

対象製品名 Table 4 (LBC7 Devices - UMC, RFAB, FFAB)

BQ24050DSQR	SN1008032RHD	TLV70229DSET	TPS53313RGET	TPS71718DCKR
BQ24050DSQT	SN1008032RHDR	TLV707285DQNR	TPS53316RGTR	TPS71718DCKRG4
BQ24305DSGR	SN1008032RHDT	TLV707285DQNT	TPS53316RGTT	TPS71718DCKT
BQ24305DSGRG4	SN1011047PWPR	TLV707T18DBVR	TPS53321RGTR	TPS71718DCKTG4
BQ24305DSGT	SN53003B4RGJR	TLV707T18DBVT	TPS53321RGTT	TPS71719DCKT
BQ24305DSGTG4	SN65HVD62RGT	TLV707T28DBVR	TPS54286PWP	TPS71719DCKTG4
BQ24308DSGR	SN65HVD62RGTR	TLV707T28DBVT	TPS54286PWPG4	TPS71721DCKR
BQ24308DSGT	SN65HVD62RTE	TLV707T33DBVR	TPS54286PWPR	TPS71721DCKT
BQ24312DSGR	SN88080A2PFBR	TLV707T33DBVT	TPS54286PWPRG4	TPS71725DCKR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

BQ24312DSGT	SN88080A4PFBR	TLV7110707DSER	TPS54295PWP	TPS71725DCKR/2801
BQ24314BDSGR	SN88080A4YS	TLV7110707DSET	TPS54295PWPR	TPS71725DCKRG4
BQ24314BDSGT	SN89062PWPR	TLV7111233DSER	TPS54329DDA	TPS71725DCKT
BQ24314BDSJR	SN98044A1RHBR	TLV7111233DSET	TPS54329DDAR	TPS71725DCKTG4
BQ24314BDSJT	SN99057RSBR	TLV7111828DSER	TPS54329EDDA	TPS71726DCKR
BQ24351DSGR	SN9C042A3RSLR	TLV7111828DSET	TPS54329EDDAR	TPS71726DCKRG4
BQ24351DSGT	SNA1038A1RGC	TLV71125125DSER	TPS54383PWP	TPS71726DCKT
BQ24750ARHDR	SNA1038A1RGCR	TLV71125125DSET	TPS54383PWPG4	TPS71726DCKTG4
BQ24750ARHDT	TAFP3001YFMR	TLV7112525DSER	TPS54383PWPR	TPS71727DCKR
BQ24751BRHDR	TLC590251DBQR	TLV7112525DSET	TPS54383PWPRG4	TPS71727DCKRG4
BQ24751BRHDRG4	TLC5948PWP	TLV7113333DSER	TPS54521RGYR	TPS71727DCKT
BQ24751BRHDT	TLC5948PWPR	TLV7113333DSET	TPS54521RGYT	TPS71727DCKTG4
BQ24751BRHDTG4	TLS2602DCARG4	TLV7114848DSER	TPS54521RHLR	TPS717285DCKR
BQ24753ARHDR	TLV11117LV07DCYR	TLV7114848DSET	TPS54521RHLT	TPS717285DCKRG4
BQ24753ARHDT	TLV11117LV07DCYT	TLV71210DSER	TPS54622RHLR	TPS717285DCKT
BQ25504RGTR	TLV11117LV12DCYR	TLV71210DSET	TPS54622RHLT	TPS717285DCKTG4
BQ25504RGTT	TLV11117LV12DCYT	TPA2016D2RTJR	TPS54623RHLR	TPS71728DCKR
BQ9000RSNR	TLV11117LV18DCYR	TPA2016D2RTJT	TPS54623RHLT	TPS71728DCKRG4
BQ9000RSNT	TLV11117LV18DCYT	TPA2016D2V3RTJR	TPS55010DGQ	TPS71728DCKT
BQA9000DBT	TLV11117LV33DCYT	TPA2016D2V3RTJT	TPS55010DGQR	TPS71728DCKTG4
DRV10863BAADSNG4	TLV11117LV45DCYR	TPA2017D2RGP	TPS55010RTER	TPS71729DCKR
HPA00259DCKR	TLV11117LV45DCYT	TPA2017D2RGPR	TPS55010RTET	TPS71729DCKRG4
HPA00338PWPR	TLV2051DBVR	TPA2017D2RTJR	TPS55386PWP	TPS71729DCKT
HPA00369DCKR	TLV2051DBVT	TPA2017D2RTJT	TPS55386PWPG4	TPS71729DCKTG4
HPA00431PWPR	TLV2062DGN	TPA2017D2V2RTJR	TPS55386PWPR	TPS71730DCKR
HPA00442PWP	TLV2062DGNR	TPA2017D2V2RTJT	TPS55386PWPRG4	TPS71730DCKRG4
HPA00443PWPR	TLV2069DBVR	TPA2018D1YZFR	TPS59316RTVR	TPS71730DCKT
HPA00547PWPR	TLV2069DBVT	TPA2018D1YZFT	TPS62110GRSAR	TPS71730DCKTG4
HPA00609DCKR	TLV2069DGN	TPA2026D2YZHR	TPS62110PWPR	TPS71733DCKR
HPA00651DR	TLV2069DGNR	TPA2026D2YZHT	TPS62110RSAR	TPS71733DCKRG4
HPA00721DR	TLV2070DGN	TPA6045A4CRHBR	TPS62110RSARG4	TPS71733DCKT
HPA00795RTJR	TLV2070DGNR	TPA6047A4RHBR	TPS62110RSAT	TPS71733DCKTG4
HPA00797DDCR	TLV2071DGN	TPA6047A4RHBRG4	TPS62110RSATG4	TPS71733DRVR
HPA00856YZFR	TLV2071DGNR	TPS2000CDGN	TPS62111RSAR	TPS71733DRVRG4
HPA00948RHHR	TLV2073DRCR	TPS2000CDGNR	TPS62111RSARG4	TPS71733DRVT
PDRV8833AOPWP	TLV2073DRCT	TPS2001CDGN	TPS62111RSAT	TPS71733DRVTG4
PPS65252AORHDR	TLV70012DCKR	TPS2001CDGNR	TPS62111RSATG4	TPS72727DSER
PSC98058A3RSLR	TLV70012DCKT	TPS2003CDRCR	TPS62112RSAR	TPS72727DSET
PSN1008032RHDR	TLV70012DDCR	TPS2003CDRCT	TPS62112RSARG4	TPS728185315YZUR
PSN89062PWP	TLV70012DDCT	TPS2051CDBVR	TPS62112RSAT	TPS728185315YZUT
PSN98044A1RHBR	TLV70012DSER	TPS2051CDBVT	TPS62112RSATG4	UCC28060D
PSN99057RSBR	TLV70012DSET	TPS2062CDGN	TPS65252RHDR	UCC28060DG4
PSNA1038A1RGC	TLV70018DCKR	TPS2062CDGNR	TPS65252RHDT	UCC28060DR
PSNA1038A1RGCR	TLV70018DCKT	TPS2065CDBVR	TPS658630ZQZR	UCC28060DRG4
PTLS2602DCAG4	TLV70018DDCR	TPS2065CDBVT	TPS658630ZQZT	UCC28230DRNR
PTLS2602DCARG4	TLV70018DDCT	TPS2065CDGN	TPS71701DCKR	UCC28230DRNRG4
PTPS54329DDA	TLV70018DSER	TPS2065CDGNR	TPS71701DCKRG4	UCC28230DRNT
PTPS54329DDAR	TLV70018DSET	TPS2069CDGN	TPS71701DCKT	UCC28230DRNTG4
PTPS54329EDDA	TLV70025DCKR	TPS2069CDGNR	TPS71701DCKTG4	UCC28230PW
PTPS54329EDDAR	TLV70025DCKT	TPS22911AYZVR	TPS71701DRVR	UCC28230PWG4
PTPS659110A2ZRCR	TLV70025DDCR	TPS22911PYZVR	TPS71701DRVT	UCC28230PWR
PTPS659112A2ZRC	TLV70025DDCT	TPS22913BYZVR	TPS71710DCKR	UCC28230PWRG4
PTPS659112A2ZRCR	TLV70025DSER	TPS22913MYZVR	TPS71710DCKRG4	UCC28231DRNR
PTPS659113A2ZRC	TLV70025DSET	TPS22924BYZR	TPS71710DCKT	UCC28231DRNRG4
PTPS659113A2ZRCR	TLV70028DCKR	TPS22924BYZT	TPS71710DCKTG4	UCC28231DRNT
PTPS80031A1CMR	TLV70028DCKT	TPS2421-1DDA	TPS71710DRVR	UCC28231DRNTG4
PTPS80031A1CMRR	TLV70028DDCR	TPS2421-1DDAR	TPS71710DRVRG4	UCC28231PW

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

PTPS80031ACMR	TLV70028DDCT	TPS2421-2DDA	TPS71710DRV1	UCC28231PWG4
PTPS80031ACMR	TLV70028DSE	TPS2421-2DDAR	TPS71710DRV1G4	UCC28231PWR
PTWL6025A1CMR	TLV70029DSE	TPS2456RHHR	TPS71711DCKR	UCC28231PWRG4
PTWL6025A1CMR	TLV70029DSE	TPS2456RHHT	TPS71711DCKRG4	UCD7232RTJR
PTWL6025ACMR	TLV70029DSE	TPS2457RHHR	TPS71711DCKT	UCD7232RTJT
PTWL6025ACMR	TLV70033DCKR	TPS2457RHHT	TPS71711DCKTG4	UCD74103RGMR
SC76008A3RSLR	TLV70033DCKT	TPS40422RHAR	TPS71712DCKR	UCD74103RGMT
SC7C061A3RSLR	TLV70033DDCR	TPS40422RHAT	TPS71712DCKRG4	UCD74106RGMR
SC85031A3RSLR	TLV70033DDCT	TPS51200QDRCTEP	TPS71712DCKT	UCD74106RGMT
SC93030A3RSLR	TLV70033DSE	TPS51219RTER	TPS71712DCKTG4	UCD74110RVFR
SC98058A3RSLR	TLV70033DSE	TPS51219RTER	TPS71713DCKR	UCD74110RVFT
SCA9030A3RSLR	TLV70220PDBVR	TPS51315RGFR	TPS71713DCKRG4	UCD74120RVFR
SN0603044RSAR	TLV70220PDBVT	TPS51315RGFT	TPS71713DCKT	UCD74120RVFT
SN0603044RSARG4	TLV70225DSE	TPS53216RTER	TPS71713DCKTG4	XSN1011047PWPR
SN1001043RHAR	TLV70225DSE	TPS53216RTER	TPS71715DCKR	XTLC5948PWP
SN1001043RHAT	TLV70228PDBVR	TPS53312RGTR	TPS71715DCKRG4	XTPS54295PWPR
SN1006043YZFR	TLV70228PDBVT	TPS53312RGTT	TPS71715DCKT	
SN1006043YZFT	TLV70229DSE	TPS53313RGER	TPS71715DCKTG4	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 10 月 6 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS51217DSC	-	-	
Wafer Fab Site:	RFAB	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char.	-	Approved	Approved	Approved
Latch-up	per JEESD78	6/0	6/0	6/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Post Temp Cycle SAM	CSAM and TSAM analysis after 1000 cycles Temp cycle	Approved	Approved	Approved
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Wafer Fab MQ	Per site spec	Approved	-	-
Assembly / Test MQ	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	Approved	-	-
High Temp. Storage Bake	170C,168, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C,500, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Steady-state Life Test Note(1)	135C,110, 320, 635 Hrs	77/0	77/0	77/0
Notes: **Preconditioning: JEDEC L-2/260C				
(1) Life test equivalent conditions;				
125C, 1000hrs				
135C, 635hrs				
140C, 480hrs				
150C, 300hrs				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 7 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SH6125BAC0PAPG4	-	-	
Wafer Fab Site:	UMC-F8AB	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	125C,1000hrs or equivalent	77/0	-	-
Electrical Char	Per datasheet spec	Approved	Approved	Approved
**High Temp. Storage Bake	170C,420hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,500 Cyc	77/0	77/0	77/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved
Latch-up	1.5xVcc/25C/250mA	6/0	6/0	6/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	65C/150C,500 Cyc	77/0	77/0	77/0
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 10 月 31 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TCA6416PW	-	-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
** Steady-State Life Test	150C,300 Hrs	116/0	116/0	116/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Bake	150C,1000 Hours	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	-	-
ESD MM	100V	3/0	-	-
ESD CDM	500V	3/0	-	-
Latch-up	per JESD78, Class II	9/0	-	-
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2003 年 6 月 18 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS65010	-	-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:	3370A12	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
** Steady-State Life Test	150C,300 Hrs	120/0	120/0	120/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 hours	80/0	80/0	80/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	80/0	80/0	80/0
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	80/0	80/0	80/0
**Thermal Shock	-65C/150C,1000 Cycles	80/0	80/0	80/0
** Storage Life	170C,420 Hrs	50/0	50/0	50/0
ESD HBM	2000V	3/0	-	-
ESD CDM	500V	3/0	-	-
Latch-up	per JESD78, Class II	5/0	5/0	5/0
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 4 月 5 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	SR3100AAA2PM	-	-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:	Bicom-3XL	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
** Steady-State Life Test	125C,1000 Hrs	116/0	116/0	116/0
** Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD MM	100V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 2 月 20 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qualification Device:	TWL3029FZQW	-	-	
Wafer Fab Site:	SMIC	Wafer Fab Process:	3370A07S	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
** Steady-State Life Test	1000 Hrs	116/0	116/0	116/0
**Biased HAST	130C/85%RH 96 hours	26/0	26/0	26/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Life	150C,600 Hours	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Latch-up	per JESD78, Class II	5/0	5/0	5/0
**Thermal Shock	200 Cycles	77/0	77/0	77/0
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

Appendix A – Associated capacity transfers

Site	Process	PCN Number
SMIC-TJ; FFAB; HIJI; RFAB; DMOS 5;	A07/A07S; A12; C18; Bicom; LBC7;	20110324000
RFAB	C05	20110104000
RFAB	LBC7	20100712000
UMC	LBC7	20100428001
UMC	LBC7	20100827001
UMC	LBC5	20100907000
Aizu	33HPA07	20101118001
Aizu	50HPA07	20101118002